平成30年５月11日

各　位

会 社 名　株式会社テラプローブ
代 表 者　代表取締役社長　渡辺 雄一郎
（コード番号：6627　東証マザーズ）
問合せ先　執行役員CFO　神戸　一仁
（TEL　045-476-5711）

連結子会社における増資払込み完了のお知らせ

本日、当社の連結子会社であるTeraPower Technology Inc.において、増資の払込みが完了しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

１．TeraPower Technology Inc.の概要

（１）商　　号　TeraPower Technology Inc.
（２）代 表 者　渡辺　雄一郎
（３）所 在 地　No.26, Wenhua Rd., Hsinchu Industrial Park. Hukou, Hsinchu 303, Taiwan
（４）資 本 金　NT$ 1,335,500,000
（５）事 業 内 容　半導体ウエハテスト受託
（６）設 立 年 月 日　平成20年８月
（７）増資前出資比率　当社　51.0%
　　Powertech Technology Inc.　49.0%

２．TeraPower Technology Inc.の増資の内容

（１）増 資 金 額　NT$ 600,029,000
　　当社出資額　NT$ 306,014,790（1,119百万円）
（２）増資後の資本金　NT$ 1,497,670,000
（３）払 込 日　平成30年５月11日
（４）増資後出資比率　当社　51.0%
　　Powertech Technology Inc.　49.0%

３．増資の理由

TeraPower Technology Inc.は、当社グループの台湾拠点として、半導体ウエハテスト受託を行っております。過去２回にわたって計NT$ 1,005,000,000の増資を実施いたしましたが、引続き台湾での需要増加が見込まれる中で生産能力の増強に対応するため、今回の増資を実施いたしました。

４．業績に与える影響について

今回の増資が当社グループに与える影響は軽微であります。

以　上